

製品概要

太陽誘電社製BLE(Bluetooth Low Energy)モジュールを、取り扱いが容易なDIP16形状にしました。端面スルーホール加工により、薄型化(厚さ約2.5mm)・小型化(23.5×8.3mm)を実現しました。ユニバーサル基板等へ直接はんだ付けすることができ、セットの薄型(厚さ約2.5mm)・小型化が可能です。ピンの列間隔が300mil(7.62mm)より広く(8.0mm)なっておりますので、ブレッドボードなどでお使いの場合は、通販番号P-03635型番 2227MC-16-03-150-F6の連結ソケット16Pのご使用をおすすめします。BLEモジュールの仕様につきましては、詳細資料がダウンロードできますので、そちらをご参照ください(要ユーザ登録…詳細はカード内側をご覧ください)。

←端面スルーホール

ブレッドボードと連結ソケット16Pとの組み合わせ例→



ブレッドボード、連結ソケットは別売です。

AE-TYBLE16

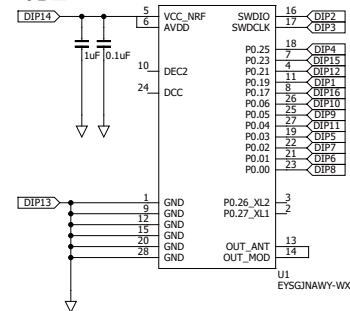
TAIYO YUDEN EYSGJN Bluetooth Ver 4.2 Low Energy Module

8.3
mm

23.5
mm

MLCC
0.1 μ F+1.0 μ F
EYSGJN
Power Supply
1.8V~3.6V

回路図



DIPで始まる表記は、モジュールのピン番号に対応します。(例) DIP1 → モジュールの1番ピン
本モジュールは、V1.3の資料に基づき部品定数を決定しております。最新版の資料とは、値が異なる場合がございます。

ピン配置

P0.19[1]	[16]P0.17
SWDIO[2]	[15]P0.23
SWDCLK[3]	[14]+V(1.8V~3.6V)
P0.25[4]	[13]GND
P0.03[5]	[12]P0.21
P0.01[6]	[11]P0.04
P0.02[7]	[10]P0.06
P0.00[8]	[9]P0.05



EYSGxNAWY-WX Data Report (full version)

詳細仕様書の入手方法

http://www.yuden.co.jp/wireless_module/Module/ にアクセスし、必要事項を入力、ユーザ登録を完了すると、詳細資料をダウンロードすることができます。登録の際には、下記コードが必要となりますので無くさないようご注意ください。

Product Passcode

ユーザ登録不要で、弊社製品ページより直接ダウンロード可能となりました。下記にアクセスいただき、データシート(EYSGJNAWY-WX)を選択ください。

<https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112339/>



太陽誘電株式会社へのお問い合わせはご遠慮ください。